

Intel Pentium Dual Core



Elementos fundamentales

Colección de productos Legacy Intel® Pentium® Processor

Nombre de código Products formerly Conroe

Segmento vertical Desktop

Número de procesador E2140

Litografía 65 nm

Especificaciones de desempeño

Cantidad de núcleos 2

Frecuencia básica del procesador 1.60 GHz

Caché 1 MB L2 Cache

Velocidad del bus 800 MHz

Paridad FSB No

TDP 65 W

David Emiliano Cepeda
Guerrero

Arquitectura de
Computadoras

Reporte Practica 2

Rango de voltaje VID 0.8500V-1.5V

Información complementaria

Estado Discontinued

Fecha de lanzamiento Q2'07

Opciones integradas disponibles No

Especificaciones de paquete

Zócalos compatibles LGA775, PLGA775

TCASE L2=61.4°C; G0+M0=73.3°C

Tamaño de paquete 37.5mm x 37.5mm

Tamaño de chip de procesamiento 77 mm²

Cantidad de transistores de chip de procesador 105 million

Intel Celeron



Elementos fundamentales

Colección de productos Legacy Intel® Celeron® Processor

Nombre de código Products formerly Tualatin

Segmento vertical Desktop

Litografía 130

nm

Especificaciones de desempeño

Cantidad de núcleos 1

Frecuencia básica del procesador 1.10 GHz

Caché256 KB L2 Cache

Velocidad del bus100 MHz

Paridad FSBNo

TDP28.9 W

Rango de voltaje VID1.475V

Información complementaria

Estado Discontinued

Opciones integradas disponiblesNo

Especificaciones de memoria

Extensiones de dirección física32-bit

Compatible con memoria ECC ‡No

Especificaciones de paquete

Zócalos compatiblesPPGA370

TCASE69°C

Tamaño de paquete49mm x 49mm

Tamaño de chip de procesamiento80 mm²

Cantidad de transistores de chip de procesador44 million

Intel Celeron D352



Elementos fundamentales

Colección de productos Legacy Intel® Celeron® Processor

Nombre de código Products formerly Cedarmill

Segmento vertical Desktop

Número de procesador 352

Litografía 65 nm

Especificaciones de desempeño

Cantidad de núcleos 1

Frecuencia básica del procesador 3.20 GHz

Caché 512 KB L2 Cache

Velocidad del bus 533 MHz

Paridad FSB No

TDP 86 W

Rango de voltaje VID 1.25V-1.325V

David Emiliano Cepeda
Guerrero

Arquitectura de
Computadoras

Reporte Practica 2

Información complementaria

Estado Discontinued

Fecha de lanzamiento Q2'06

Opciones integradas disponibles Yes

Especificaciones de memoria

Extensiones de dirección física 32-bit

Compatible con memoria ECC ‡ No

Especificaciones de paquete

Zócalos compatibles PLGA775

TCASE 69.2°C

Tamaño de paquete 37.5mm x 37.5mm

Tamaño de chip de procesamiento 81 mm²

Cantidad de transistores de chip de procesador 188 million

Intel Pentium 3



Elementos fundamentales

Colección de productos Legacy Intel® Pentium® Processor

Nombre de código Products formerly Tualatin

Segmento vertical Desktop

Litografía 130 nm

Especificaciones de desempeño

Cantidad de núcleos 1

Frecuencia básica del procesador 1.20 GHz

Caché 256 KB L2 Cache

Velocidad del bus 133 MHz

TDP 29.9 W

Rango de voltaje VID 1.5V

Información complementaria

Estado Discontinued

Opciones integradas disponibles Yes

Especificaciones de paquete

David Emiliano Cepeda
Guerrero

Arquitectura de
Computadoras

Reporte Practica 2

Zócalos compatibles PPGA370

TCASE 69°C

Tamaño de chip de procesamiento 80 mm²

Cantidad de transistores de chip de procesador 44 million

AMD Sempron SDA3000AIO2BX



General information

Type, CPU / Microprocessor

Market segment, Desktop

Family, AMD Sempron

Model number 3000+

CPU part numbers, SDA3000AIO2BX is an OEM/tray microprocessor SDA3000BXBOX is a boxed microprocessor with fan and heatsink

Stepping codes, ABBWE LBBWE LEBBE LEBCE LEBDE LFBAE LFBBE NBBWE

Frequency 3000+ (rated)
1.8 GHz / 1800 MHz (real)

Bus speed Single-channel 200 MHz DDR SDRAM Memory controller
One 800 MHz 16-bit HyperTransport link

Package, 754-pin lidded organic mPGA
1.57" x 1.57" (4 cm x 4 cm)

AMD Package numbers, 27973
29131

Socket, Socket 754

Architecture / Microarchitecture,

Instruction set, x86

Microarchitecture, K8

Processor codename, Palermo

Core stepping DH-E6

CPUID, 20FC2

Manufacturing process, 0.09 micron

Data width, 64 bit

The number of CPU cores, 1

The number of threads, 1

Floating Point Unit, Integrated

Level 1 cache size 64 KB 2-way set associative instruction cache
64 KB 2-way set associative data cache

Level 2 cache size 128 KB 16-way set associative exclusive cache

Multiprocessing, Uniprocessor

Extensions & Technologies, MMX instructionsExtensions to MMX3DNow!
technologyExtensions to 3DNow!SSE / Streaming SIMD ExtensionsSSE2 / Streaming
SIMD Extensions 2SSE3 / Streaming SIMD Extensions 3AMD64 / AMD 64-bit technology

Security Features, EVP / Enhanced Virus Protection

Low power features, Cool'n'Quiet technology

Integrated Graphics Processing Unit,

None,

Integrated peripherals / components,

| | | | | | |
|--------------------|----------|--------|----|--------------|---|
| Memory controller, | The | number | of | controllers: | 1 |
| Memory | channels | (per | | controller): | 1 |
| Memory | channels | | | (total): | 1 |

Supported memory: DDR

Other peripherals, HyperTransport technology

Electrical / Thermal parameters,

V core 1.4V

Maximum operating temperature 69°C

Thermal Design Power 59 Watt